

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2025-001

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

### 一、2024 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	177,002.60	171,696.99	3.09
营业利润	23,001.82	27,943.71	-17.69
利润总额	23,329.71	28,243.12	-17.40
归属于母公司所有者的净利润	21,090.64	25,062.62	-15.85
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	8,175.36	18,716.52	-56.32
基本每股收益（元）	1.05	1.82	-42.31
加权平均净资产收益率	8.41%	11.24%	减少 2.83 个 百分点

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	557,868.62	430,155.56	29.69
归属于母公司的所有者权益	269,855.89	238,044.03	13.36
股本	20,096.70	13,788.70	45.75
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	13.43	17.26	-22.19

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据依据财务报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年度报告为准。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入 177,002.60 万元，同比增长 3.09%；实现利润总额 23,329.71 万元，同比下降 17.40%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,090.64 万元，同比下降 15.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,175.36 万元，同比下降 56.32%。

报告期内，公司前道晶圆加工领域产品收入保持增长，其中，在前道涂胶显影领域，公司围绕下游核心客户需求，持续开展机台导入与高端工艺验证，新一代超高产能机型研发正在稳步推进中；在前道清洗领域，公司优势产品前道物理清洗机继续保持国内龙头地位，公司战略新产品前道化学清洗机客户端导入顺利，高温硫酸清洗机台顺利通过国内某重要客户工艺验证，机台现场表现优异，有望成为公司新的业务名片及业绩增长点。

报告期内，公司后道先进封装及小尺寸领域产品收入同比基本持平，作为国内市场龙头，公司深度绑定海内外重要客户，重点布局 2.5D、HBM 等新兴领域，尤其是临时键合、解键合等新品类，持续获得国内头部客户订单，验证进展顺利，公司将继续围绕 Chiplet 新技术、新工艺发展，持续拓展产品矩阵，不断推出新品类，持续强化在先进封装领域的龙头地位。

报告期末，公司总资产 557,868.62 万元，同比增长 29.69%；归属于母公司的所有者权益 269,855.89 万元，同比增长 13.36%。

本报告期公司基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产均有所下降，主要原因是报告期内公司实施 2023 年年度权益分派，以资本公积转增股本导致总股数增加。

## （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明

1、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 56.32%，主要原因是：（1）报告期内公司持续加大研发投入力度，研发费用增加；（2）报告期内随着公司规模扩大，成本费用增加；（3）报告期内计入其他收益的政府补助增加。

2、基本每股收益同比下降 42.31%，主要原因是：（1）报告期内公司净利润有所下降；（2）报告期内公司实施股权激励及 2023 年年度权益分派，总股数增加。

3、股本同比增长 45.75%，主要原因是报告期内公司实施 2023 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

## 三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2024 年年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日